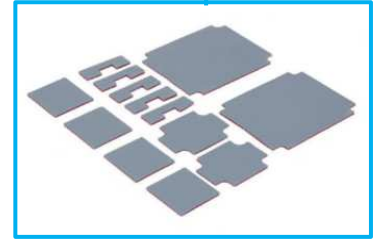


Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_078_AB_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 7.8W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

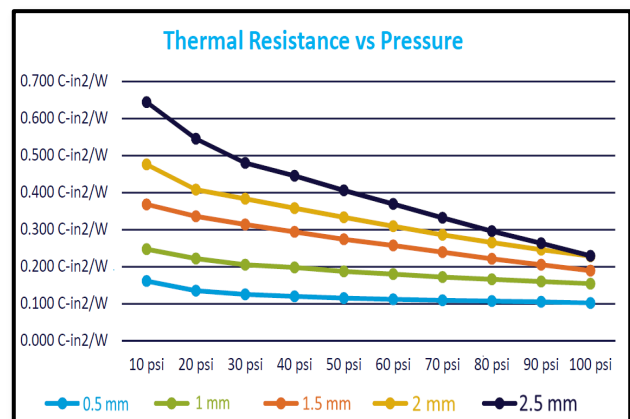
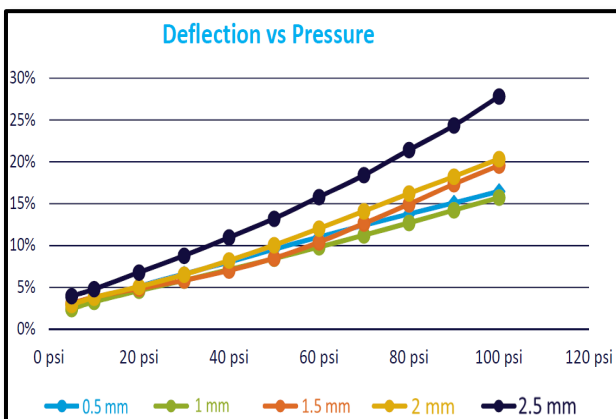


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_078_AB_NS			
Epaisseur	mm	0.5	1.0	2.0	-
Gravité Spécific	g/cm3	3.21			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore 00	81			
Taille	mm	230*230			
Résistance @90 Psi	°C-inch ² /W	0.10	0.15	0.25	-
Résistance @60 Psi		0.11	0.18	0.31	-
Résistance @30Psi		0.12	0.20	0.38	-
Conductivité thermique	W/mK	7.8			
Température	°C	-25 to 120			
Tension de claquage	kV/mm	> 3			
Résistance volumique	Ohm - cm	10 ¹⁴			
Contante dielectric	@1MHz	16			

Le TGF_078_AB_NS est disponible en 0.5 à 5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.